

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年7月31日(31.07.2025)



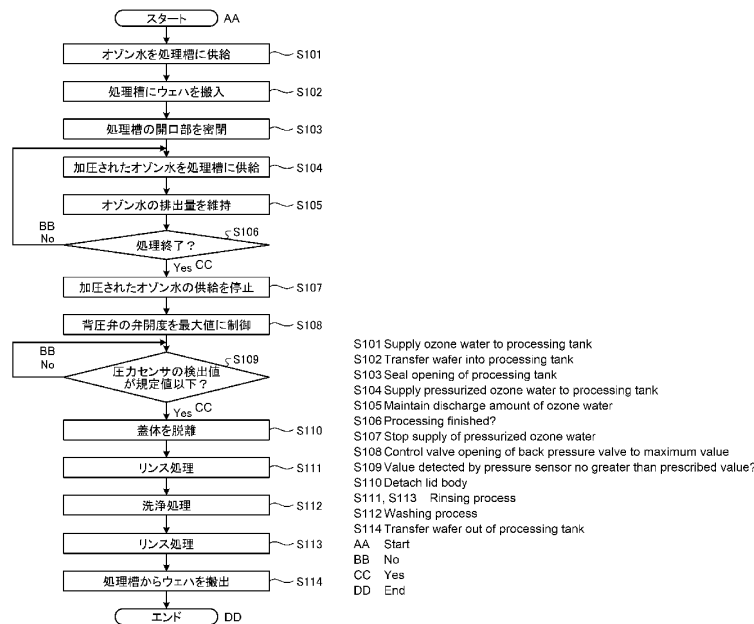
(10) 国際公開番号

WO 2025/159065 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/304 (2006.01) C01B 13/10 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2025/001676
- (22) 国際出願日: 2025年1月21日(21.01.2025)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2024-008515 2024年1月24日(24.01.2024) JP
特願 2024-179914 2024年10月15日(15.10.2024) JP
- (71) 出願人: 東京エレクトロン株式会社(TOKYO ELECTRON LIMITED) [JP/JP]; 〒1076325 東京都港区赤坂五丁目3番1号 (JP).
- (72) 発明者: 香川 興司(KAGAWA, Koji); 〒8611116 熊本県合志市福原1-1 東京エレクトロン九州株式会社内 (JP). 荒竹 英将(ARATAKE, Hidemasa); 〒8611116 熊本県合志市福原1-1 東京エレクトロン九州株式会社内 (JP). 山本 諒(YAMAMOTO, Ryo); 〒8611116 熊本県合志市福原1-1 東京エレクトロン九州株式会社内 (JP). 山下 剛秀(YAMASHITA, Masami); 〒8611116 熊本県合志市福原1-1 東京エレクトロン九州株式会社内 (JP).
- (74) 代理人: 弁理士法人酒井国際特許事務所(SAKAI INTERNATIONAL PATENT OFFICE); 〒1000013 東京都千代田区霞が関3丁目8番1号 虎ノ門ダイビルイースト (JP).

(54) Title: SUBSTRATE PROCESSING DEVICE, SUBSTRATE PROCESSING METHOD, AND STORAGE MEDIUM

(54) 発明の名称: 基板処理装置、基板処理方法および記憶媒体



(57) Abstract: This substrate processing device comprises: a processing tank; a lid body; a chemical solution supply unit; a pressurization unit; and a control unit. The processing tank has an opening in the upper part thereof, and in the processing tank, a substrate is immersed in a chemical solution and processed. The lid body is configured so as to be able to seal the opening of the processing tank. The chemical solution supply unit supplies the chemical solution to the processing tank. The pressurization unit pressurizes the chemical solution on the upstream side of the chemical solution

[続葉有]

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UY, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO(BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア(AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告(条約第21条(3))

supply unit. The control unit controls the aforementioned units. The control unit causes: the substrate to be immersed in the chemical solution stored in the processing tank; the lid body to seal the opening of the processing tank; the chemical solution pressurized by the pressurization unit to be supplied from the chemical solution supply unit to the processing tank; and the chemical solution stored in the processing tank to be pressurized.

(57) 要約: 基板処理装置は、処理槽と、蓋体と、薬液供給部と、加圧部と、制御部とを備える。処理槽は、上部に開口部を有し、基板を薬液に浸漬して処理する。蓋体は、処理槽の開口部を密閉可能に構成される。薬液供給部は、処理槽に薬液を供給する。加圧部は、薬液供給部よりも上流側で薬液を加圧する。制御部は、各部を制御する。制御部は、処理槽に貯留される薬液に基板を浸漬させ、蓋体で処理槽の開口部を密閉し、加圧部により加圧された薬液を薬液供給部から処理槽に供給して、処理槽に貯留される薬液を加圧する。